



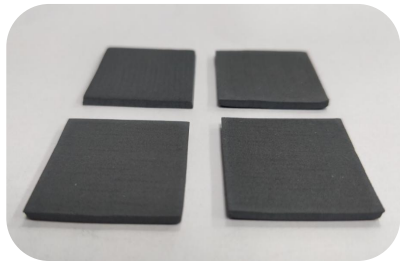
鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

HFS-15

【高效能导热垫片】规格书



- 产品图 -

应用特点：

- 高热导率和低热阻
- 低应力装配
- 良好的热稳定性性能
- 多种厚度选择，应用范围广

应用领域推荐：

- 卫星，雷达等军事领域
- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 可穿戴设备

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度：≤30℃

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：2年

不符合储存条件下：6个月

产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	黑灰色	---	目视
标准尺寸	120*120	mm	ASTM D 5947
厚 度	0.5~3	mm	ASTM D374
硬 度	65(±10)	Shore 00	ASTM D 2240
密 度	3.0(±0.2)	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥0.1	Mpa	ASTM D 412
延 伸 率	≥100	%	ASTM D 412
撕裂强度	≥0.5	N/mm	ASTM D 624
压 缩 比	≥40 (@50Psi)	%	ASTM D 695
使用温度	-50~130	℃	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	24.0(±5)	W/m•K	ASTM D 5470
热 阻	≤0.15 (@20Psi/2mm)	℃in ² /W	ASTM D 5470

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

不同压缩量对应的瞬间应力

